



CO2激光划线切割设备

CO2 laser scribing and cutting machine

CO2激光划线切割设备主要针对厚度为1mm的陶瓷基板进行划线切割加工，加工截面整洁，加工深度一致性高；CO2激光划线切割设备也可应用于直径0.3mm以上孔的加工，特别是对氧化铝有独到的加工优势。

- 高质量快速切割划线，自研软件支持DFX图形导入，可满足任意基本图形的分层划线切割加工；
- 切割深度一致性好，加工效率和稳定性高，可选配上下料机构，实现自动化操作；
- 标配辅助机器视觉及自动校准，具备高精度图像识别定位功能，实现自动对位加工。

主要技术参数	产品型号 MD-C350A
平台移动范围 (mm)	400×350
最大加工产品尺寸 (mm)	350×300
划线速度 (mm/s)	10 - 200
划线线宽 (mm)	≤ 0.15
划线深度一致性 (mm)	≤ ± 0.003
平台定位精度 (mm)	± 0.003
重复定位精度 (mm)	± 0.002
切割厚度 (mm)	≤ 1.5
设备质量 (kg)	1650
设备尺寸 (mm)	1300(宽)×1350(深)×1700(高)

